

eMemory 3Q25 Earnings Call Q&A Transcript

November 14th, 2025, 16:00-17:00 Taiwan Time

Q&A Transcript

1. 公司剛剛分享 PUF 技術在國防領域的應用，想請問這樣的成功案例是否有機會進一步拓展至其他高端市場領域？

>>是的，PUF 作為 unique ID 以及 secret key seed 在 security 方面有許多的應用，目前我們正與合作夥伴推進以下專案：

1. **Chiplets**：用於供應鏈安全，確保每個晶片都具備身分驗證功能。
2. **Caliptra for Data Centers**：建立信任根（Root of Trust），提供唯一識別、金鑰儲存與亂數產生。
3. **PUFido**：開發無密碼驗證（Passwordless Authentication）方案，提升登入與身分驗證安全性。
4. **比特幣託管服務**：利用 PUF 保護加密貨幣私鑰，確保資產安全。
5. **去中心化身分（DID）**：用於保護病患醫療資料隱私，建立去中心化驗證機制。

2. 公司過去曾與 NVIDIA 探討過合作的可能性，當時由於 4-5nm 製程尚未通過認證，合作未能成行。現在，隨著技術進步，是否仍在持續尋求與 NVIDIA 的合作？若有，是否直接進入 3nm 製程，或已可在 4-5nm 製程上進行合作？此外，我們希望公司能積極進入 NVIDIA 和 AMD 兩大 GPU 生態系統。

>>我們的合作仍在積極推進中。目前，我們的技術和產品已經成熟，並且在推動 AI 與資料安全領域的發展中，扮演著越來越關鍵的角色。我們有信心能夠在這個生態鏈中擁有更大的滲透機會。

3. 是否看到客戶移往美國本土製造？對公司的實值影響？

>>我們技術已經授權給美國所有晶圓代工廠，客戶不管在那裡生產，對我們都沒影響。

4. 除了積極與 NVIDIA 合作外，公司是否也在與四大 CSP 在其自研 AI ASIC 晶片領域展開合作？

>>我們目前已在 DPU 與 CPU 應用領域，與多家領先企業展開深度合作。同時，我們也持續四大 CSP 保持交流，致力於在 AI 和資料安全平台的發展中發揮我們技術的關鍵價值。我們相信這些合作將為公司帶來顯著的成長機會。

5. 請問是否有客戶導入 PQC（後量子加密）？HSM 是否已經有客戶？

>>PQC 已經有 2 個晶片客戶導入，HSM 已經 1 家簽約，還有 2 家正在進行。

6. 在先前的法說會中，公司提到 **BMC** 晶片將使用力旺的 IP，請問目前該領域的滲透率如何？我們知道 **BMC** 晶片的全球市佔率最高的是信驊，是否與其有客戶關係？若沒有，是否會影響滲透率的提升？

>>目前市場上的主流 **BMC** 晶片公司已廣泛採用我們的解決方案。通過提供完整的 **Root of Trust** 元件組合，包括 **OTP**、**PUF** 和 **TRNG** 等技術，我們能夠全面滿足 **BMC** 晶片對於安全性和可靠性的核心需求，並已獲得廣泛應用。隨著市場對高強度安全需求的持續增長，我們也看到了在整個生態鏈中進一步擴大滲透率的潛力。

7. 近期記憶體因為 **AI** 需求產生變化，請問公司是否受惠？

>>我們直接導入的記憶體應用是台灣客戶的 **DDR 4** 及 **DDR 5** 的 **DRAM repair**，這部分權利金會隨客戶生產線擴大及導入更多客製化特殊型記憶體應用而成長，也很積極在擴展客戶群中。此外，韓系客戶會在明年 **Q1** 量產的 **DDR5** 模組，會有導入 **NeoEE** 的 **SPD hub** 跟 **PMIC** 開始貢獻權利金。在 **Flash** 的應用分面，**PUF** 已經累積超過 20 個以上 **SSD controller**（有美國、台灣、中國等多個客戶），這部分有些是受 **Caliptra** 對安全性的要求而用在 **AI** 及 **enterprise server**，做為 **flash** 記憶體保護，也導入客戶開發的 **HBF**。這部分因為是在 **12nm~5nm** 製程，加上客戶與 **tape out** 數都很多，對權利金會有明顯貢獻。此外，這對於我們擅長的 **embedded** 記憶體技術，產生結構性的驅動，帶動近期很多大客戶對 **embedded ReRAM** 及 **Neoflash** 的需求。

8. 請問成熟製程代工價，是否有繼續跌價？

>>今年以來，成熟製程代工價已趨於平穩，部分記憶體，像 **NOR Flash** 可以用邏輯製程製造，加上 **HBM base die** 也轉往晶圓代工廠生產，有聽客戶提甚至有漲價可能。

9. 目前公司在 **3nm**、**4nm** 和 **5nm** 製程的 **Tape-out** 或量產進度如何？是否有新的客戶案件正在導入？在先進製程上的權利金貢獻預計會在何時放大？

>>我們目前在 **7nm** 以下的先進製程已經累計有超過 60 個 **design-win**，特別在第四季已經簽下超過 20 個 **3nm tape outs**，這是公司在主流先進製程的重大突破。**7/6nm** 已經開始貢獻權利金，**5/4/3nm** 會陸續跟上，我們對先進製程對未來貢獻很有信心。

10. 請問與 **ARM** 的合作進展為何？

>>我們正在加速合作開拓新的領域，除了已進入 **Arm CSS** 伺服器的 **CSP** 用戶，也正參與車用，以及工業用的產品，我們透過 **arm** 給到終端客戶的都是三奈米的 **PUF HRoT**。今年已經有 2-3 個新的客戶合作案。

除了將我們 **PUF IP** 做為 **Arm CSS** 產品線的信任根以作為標準外，我們更積極的與 **Arm** 以及 **Arm** 的合作夥伴與終端客戶共同合作上層的軟體與 **PQC IP**。

Arm 對於我們的三奈米 **PUF** 非常的讚賞與信任，我們是目前 **3nm** 唯一有 **silicon design proven** 的 **security IP**。搭配 **Arm CSA** 的架構，以及未來 **Arm** 要深化 **AI** 的 **design**，我們也在持續與 **arm** 共同進行 **chiplet security** 在 **SoC** 上的設計。

11. 公司在強化組織韌性與營運效率方面，有沒有觀察到具體成果？

>>在強化組織韌性與營運效率方面，我們在今年透過 AI 導入與組織優化，已看到一些明顯成效。

1. **研發效率：**AI 應用於 IP 開發與驗證的參數優化與自動化測試，縮短設計週期、提升生產力。
2. **客戶支援：**AI 輔助 design kits 生成自動化與版本管理，更快速回應 Design-in 案件，能降低錯誤率和加速客戶導入設計的時程。
3. **營運流程：**從組織優化加上導入 AI 與數據分析，提升協作效率與資訊透明度，進行流程改善與自動化導入，來降低人工作業成本。

整體而言，AI 導入使我們在研發自動化、客戶服務效率及營運成本控管上有些實質成果，進一步強化了組織的韌性與競爭力。

這次內部改革的效率，是從整個制度面著手，比預期中的快速，已經明顯看到不管是員工心態及工作效率的改善，相信對未來公司的競爭力有長遠影響。

12. 近期市場反應較為波動，請問公司如何應對目前市場信心？

>>我們有注意到近期市場反應較為波動，可能是反映市場的情緒和關注，而不是公司基本面的變化。

就經營面來看，我們的研發、客戶合作以及 AI 相關應用導入的進展都穩定進行，royalty 與 Design-in 案件也持續增加。

公司財務結構健康，我們會持續專注在技術與客戶價值的提升，也會持續溝通經營成果，讓市場更了解我們長期的潛力與韌性。

過去以來，我們一直在既定的生意軌道上前進，我們的生意沒有捷徑，收到的每一塊錢都需要長期的耕耘累積而來，但也同樣的，這種建構在專利權與強大晶圓代工廠生態系的生意模式，不會因資本市場而改變。我們會更努力與資本市場溝通，讓市場看到我們的價值。